

证券代码：300456

证券简称：赛微电子

公告编号：2023-104

## 北京赛微电子股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

### 一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

### 二、公司基本情况

#### 1、公司简介

股票简称	赛微电子	股票代码	300456
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张阿斌	刘波	
电话	010-82252103	010-82251527	
办公地址	北京市西城区裕民路 18 号北环中心 A 座 2607 室、北京市北京经济技术开发区科创八街 21 号院 1 号楼	北京市西城区裕民路 18 号北环中心 A 座 2607 室、北京市北京经济技术开发区科创八街 21 号院 1 号楼	
电子信箱	ir@smeiic.com	ir@smeiic.com	

#### 2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	396,907,735.48	377,431,827.16	5.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-27,440,797.46	8,298,711.72	-430.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-61,965,834.59	-61,880,531.59	-0.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,426,331.00	22,734,652.91	-93.73%
基本每股收益（元/股）	-0.0374	0.0114	-428.07%
稀释每股收益（元/股）	-0.0374	0.0114	-428.07%
加权平均净资产收益率	-0.55%	0.16%	-0.71%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减
总资产（元）	6,894,577,445.25	6,976,772,445.36	-1.18%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,986,852,285.64	4,981,088,435.88	0.12%

### 3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	66,189	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
杨云春	境内自然人	25.13%	184,346,719	147,507,539.00	质押	99,516,887
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	11.05%	81,016,500	0		
青岛经梅投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.68%	12,330,000	0		
国泰君安证券股份有限公司—国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	1.06%	7,810,249	0		
中金期货有限公司—中金期货—融汇 1 号资产管理计划	境内非国有法人	1.06%	7,748,934	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.93%	6,829,772	0		
中国银河证券股份有限公司	国有法人	0.67%	4,929,516	0		
刘琼	境内自然人	0.66%	4,875,372	0		
吕银用	境外自然人	0.39%	2,891,800	0		
华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	国有法人	0.37%	2,712,127	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东杨云春、国家集成电路产业投资基金股份有限公司、刘琼之间不存在关联关系，亦不存在一致行动关系。除此之外，公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或是否存在一致行动关系。					

前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用。
-------------------------------	------

公司是否具有表决权差异安排

是 否

#### 4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

#### 5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

#### 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

### 三、重要事项

#### （一）整体经营情况概述

报告期内，公司进一步聚焦 MEMS 主业；在复杂的国际政治经济环境下，叠加市场需求波动等因素的影响，公司 MEMS 主业在整体上仍保持了相当的韧性并为下一步的发展准备了较为良好的基础。公司主营业务 MEMS（微机电系统）工艺开发与晶圆制造具备全球竞争优势，拥有业内顶级专家与工程师团队以及境内外持续扩张的 8 英寸成熟产能，在市场需求波动时期仍能够把握通讯、生物医药、工业汽车、消费电子等各类应用领域的商业机会。

对于瑞典 MEMS 产线，在经历了 2022 年的国际地缘政治冲突、通货膨胀高企、收购德国 FAB5 意外失败等事件之后，自 2023 年初开始订单、生产与销售状况逐步恢复，盈利能力呈回升态势，且通过添购部分设备、收购半导体产业园区（土地面积为 43,771 平方米，建筑物面积为 19,270 平方米）等措施为进一步增加境外产能准备条件，以满足相关客户（尤其是欧美客户）当前与未来的工艺开发及晶圆制造需求。

对于北京 MEMS 产线，在经历数年的磨砺奋斗之后，在 2023 年上半年继续处于运营初期的产能爬坡阶段，制造晶圆中已实现量产的消费电子产品市场需求下滑、客户的订单和回款情况不及预期，而来自通讯、工业汽车、生物医药领域附加值较高的晶圆仍处于工艺开发、产品验证或风险试产阶段，产能利用率水平较低，实现的收入规模也仍停留在较低水平；而产线的产能建设和人员团队扩充工作持续进行，折旧摊销压力巨大，同时继续保持了较高的研发强度，最终导致了较大亏损；但由于较好地控制了工厂的成本费用支出，北京 MEMS 产线在报告期的亏损金额较上年同期有所收窄。进入 2023 年下半年，随着消费电子晶圆需求的复苏，通讯、工业汽车、生物医药领域新的晶圆类别陆续实现量产，北京 MEMS 产线的订单、生产与销售状况将随之大幅改善，产能利用率将得到显著提升。

与此同时，虽然公司在报告期内的销售费用、管理费用实现下降，但相较上年同期，本报告期未发生参股子公司股权出售、产业基金回报分配所产生的投资收益，最终导致报告期仍录得亏损。

报告期内，公司实现营业收入 39,690.77 万元，较上年同期上升 5.16%；实现营业利润-6,521.21 万元，较上年同期大幅下降 63.31%；实现利润总额-6,522.56 万元，较上年同期大幅下降 62.32%；实现净利润-6,104.84 万元，较上年同期大幅下降-70.49%；实现归属于上市公司股东的净利润-2,744.08 万元，较上年同期大幅下降 430.66%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6,196.58 万元，较上年同期下降 0.14%。报告期内，公司基本每股收益-0.0374 元，较上年同期下降 428.07%；加权平均净资产收益率-0.55%，较上年同期下降 0.71%（绝对数值变动），主要是由于归属于上市公司股东的净利润同比下降 430.66%。本报告期末，公司总资产 689,457.74 万元，较期初下降 1.18%；归属于上市公司股东的所有者权益 498,685.23 万元，股本 733,497,134.00 元，归属于上市公司股东的每股净资产 6.80 元，较期初基本持平。

此外，公司持有的长期股权投资的收益合计为-351.64 万元；公司主营业务活动陆续取得系列政府补助，其中部分补助在本报告期内补偿了部分相关成本费用或损失，非经常性损益对公司当期归母净利润的影响为 3,452.50 万元。

## （二）主要业务情况

### 1、MEMS 主业发展情况

报告期内，公司 MEMS 主业在整体上仍保持了相当的韧性并为下一步的发展准备了较为良好的基础。一方面，瑞典 FAB1&FAB2 产线继续按计划推动新增产能的磨合、持续调试产线以实现成熟运转，继续扩大 MEMS 中试服务领域、丰富工艺组合，并通过添购瓶颈设备、收购半导体产业园区等措施为进一步增加产能准备条件；另一方面，在完成基础工艺积累的情况下，北京 FAB3 产线继续保持研发投入，结合市场需求积极突破传感、射频、光学、生物等各领域各类 MEMS 器件的生产诀窍，推动客户不同类别晶圆的试产及量产导入，为产线的产能爬坡和规模量产集聚条件。

报告期内，公司 MEMS 主业实现收入 36,099.79 万元，与上年同期基本持平；其中，MEMS 晶圆制造实现收入 23,188.74 万元，较上年同期上升 24.53%，MEMS 工艺开发实现收入 12,911.04 万元，较上年同期下降 24.68%，上述变化的主要原因是：基于公司的境内外“双循环”服务体系战略以及旗下不同中试线及量产线的定位，在保证工艺开发业务前置导入的同时，瑞典 FAB1&FAB2、北京 FAB3 在当前阶段均对晶圆制造业务有所倾斜重视，以逐步适应下一阶段以规模量产为主的业务形态。

报告期内，公司 MEMS 业务的综合毛利率为 33.52%，较上年同期基本持平；其中 MEMS 晶圆制造毛利率为 32.57%，较上年上升 16.33%（绝对数值变动），MEMS 工艺开发毛利率为 35.21%，较上年下降 16.49%（绝对数值变动），上述变化的主要原因是：随着 MEMS 晶圆制造业务的逐步稳定发展，在股权激励成本费用因素影响降低的情况下，原材料、人工、制造费用等形成的成本结构趋于稳定，毛利率水平得到恢复提升，未来需进一步释放规模效应；MEMS 工艺开发属于面向市场需求的导入业务，不同时期的客户产品结构以及工艺技术解决的进度和成本均存在较大的不确定性，导致该业务的毛利率水平往往波动较大。整体而言，尽管北京 FAB3 处于运营初期，其 MEMS 业务的综合毛利率为-18.06%，远低于瑞典产线，但在当前阶段公司 MEMS 业务在整体上仍保持了较好的毛利率水平。

报告期内，得益于 MEMS 应用市场的高景气度，并基于持续扩充的瑞典产线及北京产线，公司积极开拓全球市场，并积极承接通讯、生物医疗、工业汽车、消费电子等领域厂商的工艺开发及晶圆制造订单，继续服务全球 DNA/RNA 测序仪、光刻机、红外热成像、计算机网络及系统、元宇宙、硅光子、AI 计算、ICT、新型医疗设备巨头厂商以及工业汽车和消费电子细分行业的领先企业。

报告期内，公司瑞典 FAB1&FAB2 升级改造完成后的产能逐步磨合且收购了半导体产业园区，其自身的 MEMS 工艺开发及晶圆制造业务的保障能力均得到加强；公司北京 FAB3 持续扩大覆盖不同的产品及客户，积极推进产能及良率爬坡，并进一步扩充产能。随着瑞典产线产能利用率的恢复提升，北京产线整体运营状态的持续提升，以及公司正在推进的粤港澳大湾区产线布局，公司境内外同时拥有不同定位的合格产能，不同产线在产能、市场等方面的协同互补将有力保证公司继续保持纯 MEMS 代工的全球领先地位。

### 2、研发情况

报告期内，公司继续重视技术和产品的研发投入，包括人才的培养引进及资源的优先保障。公司 MEMS 主业属于国家鼓励发展的高技术产业和战略性新兴产业，也需要公司进行重点、持续的研发投入。2023 年上半年，公司共计投入研发费用 17,576.55 万元，较上年同期增长 26.37%，占营业收入的 44.28%，研发投入的规模和强度继续呈现出极高的水平。

### 3、投融资情况

报告期内，公司终止德国产线收购事项，同时为更好地服务于 MEMS 主业发展，根据长期发展战略继续开展投融资活动：（1）收购交易方面，与德国 Elmos 签署《SPA 终止协议》，终止收购该条汽车电子芯片产线；与 Corem Stockholm Holding AB 签署协议，完成收购位于瑞典斯德哥尔摩的半导体产业园区；（2）股权投资方面，基于业务发展需要，公司全资子公司微芯科技与参股子公司赛微私募共同投资设立科莱恩特；（3）股权调整方面，推动聚能创芯以投前 10 亿人民币估值进行股权融资，加快其业务发展；调整聚能国际股权，支持参股子公司的股权融资；（4）产业基金方面，共同推动北京传感基金完成工商注册登记及私募基金备案，推动基金在智能传感领域的项目投资；继续跟踪青岛半导体产业基金、北斗产业基金的投资与投后情况，关注赛微私募基金的运行情况；（5）股权激励方面，根据公司 2021 年限制性股票激励计划操作部分股票上市以及部分股票回购注销/作废；（6）融资租赁方面，瑞典 Silex 与赛莱克斯北京继续执行相关融资租赁交易。